



Brüssel, den 9. September 2025
(OR. en)

12656/25
ADD 1

ENV 815
MI 635
DELECT 125

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absender: | Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission |
| Eingangsdatum: | 8. September 2025 |
| Empfänger: | Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Komm.dok.: | C(2025) 5939 final - Annex |
| Betr.: | ANHANG der Delegierten Richtlinie der Kommission zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für Blei hochschmelzenden Loten |

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2025) 5939 final - Annex.

Anl.: C(2025) 5939 final - Annex



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 8.9.2025
C(2025) 5939 final

ANNEX

ANHANG

der

Delegierten Richtlinie der Kommission

**zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf eine Ausnahme für Blei hochschmelzenden Loten**

ANHANG

Anhang III Ausnahme 7a der Richtlinie 2011/65/EU erhält folgende Fassung:

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „7a. | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 30. Juni 2027 ab. |
| 7a. I | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) für interne Kontaktverbindungen zur Chipbestückung oder für andere, neben einem Chip vorhandene Bauteile in einer Halbleiterbaugruppe in stationärem Zustand oder mit transienten Strömen/Impulsströmen von 0,1 A oder höher oder Sperrspannungen über 10 V oder für Chips mit einer Kantenlänge von mehr als 0,3 mm x 0,3 mm | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab. |
| 7a. II | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) für integrierte (d. h. interne und externe) Verbindungen bei der Chipbestückung von elektrischen und elektronischen Bauteilen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: – die thermische Leitfähigkeit des gehärteten/gesinterten Werkstoffs zur Chipbestückung beträgt $> 35 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, – die elektrische Leitfähigkeit des gehärteten/gesinterten Werkstoffs zur Chipbestückung beträgt $> 4,7 \text{ MS}/\text{m}$, – die Solidustemperatur ist höher als $260 \text{ }^\circ\text{C}$ | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab. |
| 7a. III | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) für Lötverbindungen der ersten Stufe (interne oder integrierte Verbindungen – d. h. interne und externe | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende |

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Verbindungen) zur Herstellung von Bauteilen, sodass es bei der anschließenden Montage elektronischer Bauteile auf Baugruppen (d. h. auf Module, Subplatinen, Substrate oder beim Punkt-zu-Punkt-Löten) mit einem Sekundärlot nicht zu einer Vermengung mit dem ersten Lot kommt. Dieser Untereintrag schließt Anwendungen zur Chipbestückung und hermetische Versiegelungen aus | Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab. |
| 7a. IV | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) für Lötverbindungen der zweiten Stufe zur Befestigung von Bauteilen auf Leiterplatten oder Lead-Frames: 1. in Lotkugeln für die Befestigung von keramischen Gehäusen in Kugelgitteranordnung (BGA, Ball Grid Array) 2. in Hochtemperaturkunststoff-Spritzgussverfahren (> 220 °C) | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab. |
| 7a. V | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) als Werkstoff zur hermetischen Versiegelung zwischen: 1. einem keramischen Gehäuse oder Stecker und einem Metallgehäuse, 2. Bauteilanschlüssen und einem internen Unterteil | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab. |
| 7a. VI | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) zur Herstellung elektrischer Verbindungen zwischen den Lampenbauteilen in Reflektorglühlampen für Infrartheizgeräte, Hochdruckentladungslampen oder Lampen für Backöfen | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab. |
| 7a. VII | Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei) | Gilt für alle Kategorien (ausgenommen unter |

| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | für Audiowandler mit einer maximalen Betriebstemperatur von mehr als 200 °C | Ausnahme 24 dieses Anhangs fallende Anwendungen) und läuft am 31. Dezember 2027 ab.“ |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|